

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润-29,226,524.79 元，未弥补亏损 29,226,524.79 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

截止 2019 年 6 月公司净利润-4,556,387.09 元，且于 2019 年 6 月 30 日，豪帮高科公司的财务报表未分配利润-29,226,524.79 元。虽然半年度营业收入有所提升，但还是继续亏损，主要原因：

1、2019 年上半年度在 2018 年度研发费用基础上新增研发费用 665 万元，主要原因是新投入开发的集成电路事业部的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的产品研发所致。

2、2018 年公司针对集成电路事业部和传感器事业部新增大批先进设备，用于硅麦传感器、光耦合芯片等系列产品规模化生产，固定资产折旧增加。但产能在 2019 年上半年还没有显现出来。

三、采取措施

1、研发投入与业绩显现之间存在时间差属于正常现象，2019年度按照计划集成电路事业部的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目继续加大研发投入，经营业绩在2019年下期有所显现，预计未来会给公司带来利润。

2、公司将继续开拓电子产品事业部新优质客户，与新客户合作的新能源汽车类产品、工业控制器、手机摄像头VCM组件等多类型产品在2019年下半年会进入量产阶段，电子产品事业部业绩会有所改善。集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等IC封装客户已进入量产阶段。传感器事业部在2019年继续开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，已经成功试产的传感器类新产品在2019年下半年会进入规模化生产，使经营业绩会有大幅提升。

3、公司会继续合理缩减开支，降低运营成本，使得成本控制在更合理的范围。

四、备查文件目录

《无锡豪帮高科股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

《无锡豪帮高科股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019年8月26日